

DDR4 SO DIMM Sockets

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽



DRAM 类型: 小型 (SO)

堆叠高度: 8 mm

模块方向: 直角

位数: 260

中心线 (间距) : .5 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D33047-SO1339
---------	-------------------

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
DRAM 类型	小型 (SO)

结构特性

行数	2
钥匙数	1
模块方向	直角
位数	200, 260

电气特征

DRAM 电压 (V)	1.2
-------------	-----

信号特征

SGRAM 电压 (V)	1.2
--------------	-----

主体特性

固定柱材料	不锈钢, 铜合金
模块钥匙类型	右偏移, 左偏移
弹射器位置	两端
弹射器类型	锁定
插销材料	高温热塑塑料

固定柱位置	两端
-------	----

连接器外形	低, 高
-------	------

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
----------------	----

端子基材	铜合金
------	-----

内存插槽类型	内存卡
--------	-----

端子额定电流 (最大值) (A)	.5
------------------	----

端子底板材料	镍
--------	---

端子接触部电镀材料	金 (Au), 镀金
-----------	------------

端子接合区域电镀材料厚度 (μm)	.127, .254, .381, .76
-------------------	-----------------------

端子接合区域电镀材料厚度 (μin)	5, 10, 15, 30
--------------------	---------------

端接特性

插入种类	凸轮
------	----

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准类型	反向键控, 标准键控
--------	------------

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	焊钉
------------	----

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	高温热塑塑料
------	--------

中心线 (间距) (mm)	.5, 2.1, 3.3, 5.4, 6.1, 7.3
---------------	-----------------------------

中心线 (间距) (in)	.02, .082, .129
---------------	-----------------

尺寸

堆叠高度 (mm)	4, 5.2, 8, 9.2
-----------	----------------

堆叠高度 (in)	.157, .205, .315, .362
-----------	------------------------

行间距 (mm)	8.2
----------	-----

行间距 (in)	.322
----------	------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 85
-------------	----------

工组温度范围 (°F)	-67 - 185
-------------	-----------



操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	500, 800, 900
封装方法	卷带包装

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 5)

DDR4 SODIMM 260P 8.0H
RVSDDR4 SODIMM 260P 5.2H
RVSDDR4 SODIMM 260P 9.2H
STDDDR4 SODIMM 260P 4.0H
RVS

TE 产品编号	2309412-2	2309410-5	2309413-5	2309408-5
堆叠高度	8 mm	5.2 mm	9.2 mm	4 mm
位数	260	200, 260	260	260
中心线 (间距)	.5 mm	.5 mm	.5 mm	.5 mm
连接器外形	高	低	高	低
端子接触部电镀材料	金 (Au)	金 (Au)	金 (Au)	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.127 μm	.76 μm	.76 μm	.76 μm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)



DDR4 SODIMM 260P 8.0H
STD



DDR4 SODIMM 260P 8.0H
RVS



DDR4 SODIMM 260P 4.0H
STD



DDR4 SODIMM 260P 5.2H
STD

TE 产品编号	2309411-2	2309412-5	2309407-4	2309409-5
堆叠高度	8 mm	8 mm	4 mm	5.2 mm
位数	260	260	260	260
中心线 (间距)	.5 mm	.5 mm	.5 mm	.5 mm
连接器外形	高	高	低	低
端子接触部电镀材料	金 (Au)	金 (Au)	金 (Au)	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.127 μm	.76 μm	.381 μm	.76 μm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)



DDR4 SODIMM 260P 9.2H RVS



DDR4 SODIMM 260P 4.0H STD



DDR4 SODIMM 260P 9.2H STD



DDR4 SODIMM 260P 4.0H RVS

TE 产品编号	2309414-2	2309407-5	2309413-2	2309408-3
堆叠高度	9.2 mm	4 mm	9.2 mm	4 mm
位数	260	260	260	260
中心线 (间距)	.5 mm	.5 mm	.5 mm	.5 mm
连接器外形	高	低	高	低
端子接触部电镀材料	金 (Au)	金 (Au)	金 (Au)	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.127 μm	.76 μm	.127 μm	.254 μm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



DDR4 SODIMM 260P 5.2H
STD

DDR4 SODIMM 260P 5.2H
STD

DDR4 SODIMM 260P 4.0H
RVS

DDR4 SODIMM 260P 8.0H
STD

TE 产品编号	2309409-3	2309409-4	2309408-4	2309411-3
堆叠高度	5.2 mm	5.2 mm	4 mm	8 mm
位数	260	260	260	260
中心线 (间距)	.5 mm	.5 mm	.5 mm	.5 mm
连接器外形	低	低	低	高
端子接触部电镀材料	金 (Au)	金 (Au)	金 (Au)	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.254 μm	.381 μm	.381 μm	.254 μm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)



DDR4 SODIMM 260P 5.2H
STD



DDR4 SODIMM 260P 9.2H
STD



DDR4 SODIMM 260P 9.2H
RVS



DDR4 SODIMM 260P 4.0H
STD

TE 产品编号	2309409-2	2309413-3	2309414-3	2309407-1
堆叠高度	5.2 mm	9.2 mm	9.2 mm	4 mm
位数	260	260	260	260
中心线 (间距)	.5 mm	.5 mm	.5 mm	.5 mm, 2.1 mm
连接器外形	低	高	高	低
端子接触部电镀材料	金 (Au)	金 (Au)	金 (Au)	镀金
端子接合区域电镀材料厚度	.127 μm	.254 μm	.254 μm	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM	DDR4 DIMM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

